

技術資料

EP-2101-8

B-Stage 絕緣接著膠

簡介:

EP-2101-8 是設計用於電子元件封裝和鋼板印刷等製程。這種材料非常適合需要最小上膠誤差和溢膠範圍的晶元級封裝。EP-2101-8 是一種低儲存模量的接著劑，是大尺寸、大面積模具的理想選擇。

特徵:

- 適用於劃膠、鋼板印刷製程
- 低板彎收縮
- 優秀的密著能力

硬化前特性		測試條件	測試方法
外觀	白色		
黏度 @ 25°C	32000 cps	Brookfield DV-III/CP-51 @ 5rpm	FT-P006
搖變指數 @ 25°C	2.3	Brookfield DV-III/CP-51 Visc @ 0.5rpm/Visc @ 5rpm	FT-P008
B-stage 後使用壽命@ 25°C	7 天	黏度升高 25%@ 5rpm	FT-P024
保存期限 @-40 °C	12 個月		FT-P018
硬化條件		測試條件	測試方法
B-stage 硬化條件		常溫加熱至 100 °C 30 分鐘 & 恆溫 100 °C 1 小時。 <u>使用者可依製程及環境需求調整溫度與時間，控制 B-Stage 後膠的軟硬程度，及壓合時所需的壓力大小，以得到後續 C-Stage 後，最佳的密合與黏著力</u>	
C-stage 硬化條件		常溫加熱至 175 °C 30~60 分鐘; 恆溫 175 °C 30 分鐘。 <u>溫度越高，時間越短，Tg 越高</u>	
機械性質		測試條件	測試方法
推力 @ 25°C	>5 kg/die	2×2mm Si die on Microscope Slide Glass	FT-M012
推力 @260°C	>1 kg/die	2×2mm Si die on Microscope Slide Glass	FT-M012

p.s. 此表僅為 Feedpool 實驗室的測試數據，客戶在投入生產之前仍需對產品進行完整的驗證測試。

物理化學性質		測試條件	測試方法
玻璃轉移溫度(Tg)	40 °C	DMA 3 點彎曲模式	FT-M014
熱膨脹係數		TMA 膨脹模式	FT-M016
< Tg	105 ppm/°C		
> Tg	309 ppm/°C		
儲存模數		DMA 3 點彎曲模式	FT-M019
@25°C	161 MPa	試片厚度 <1.5 mm	
@150°C	4 MPa		
@250°C	7 MPa		

p.s. 此表僅為 Feedpool 實驗室的測試數據，客戶在投入生產之前仍需對產品進行完整的驗證測試。

運用指導方針

運輸

運送過程皆放入乾冰或低溫冰袋等低溫保存並放置溫度指示劑以確保產品品質。當您收到貨品時發現已無乾冰殘留（或溫度指示劑呈現液態），請立即拍照存證勿使用並立刻通知我司營業人員。

解凍處理

解凍時，請將針筒（瓶、罐）直立解凍，直到完全達室溫時才能使用（一般包裝回溫時間60分鐘），請擦乾解凍時凝結在包裝外的水氣；不可反覆解凍及冷凍以防止異常分離現象及氣泡等之產生。

儲存條件

當您收到貨品時，請立即以低溫（-20°C 或 -40°C）儲存。由於不同溫度下之保存將影響產品的壽命（保存溫度與產品壽命成正比）